

0.06~1.6mmのメッキされた極薄材基板の端面バリ取り加工が可能!!

Barr removal from outer form of the plating board.

- 穴加工されたパネルの面取り加工も可能
- 0.06mmの薄板基板のバリ取り加工が可能。
- エッジからのメッキバリやメッキはがれが無くなり、工程内で不良発生要因なし。

省エネルギー
比べて
ください!

約20%
消費電力ダウン
(当社はモデルMMD-800と比較)

フルオープンが可能のため、
カッターの交換が容易にできます。
Machine can fully open as shown for easy
cutter replacement.



反転機
Turn Unit Machine
MTC-800

コーナー面取機
Corner Beveling Machine
HCR-650F4

プリント基板薄板面取機
4 side Thin Panel Beveling Machine
MMD-650

プリント基板薄板面取機
4 side Thin Panel Beveling Machine
MMD-650

消費電力
4.3kwh

CO₂排出量/時間
CO₂ emissions/hour
0.497 kg-CO₂/kWh

加工の流れと状態 Cutting process

